

學程描述：

本微學程聚焦半導體製造核心鏈，學生將掌握從有機光電材料特性、晶圓製程、電漿蝕刻應用到後段封裝測試的完整技術素養。透過產業趨勢分析、製程模擬與技術案例拆解，學生能深度理解半導體產業鏈的運作邏輯與技術實務。

課程組合：

必選修	課程編碼	科目名稱	學分	課程群/分類
選修	CHE3024	有機光電材料概論	3	1.基礎
選修	CHE4035	半導體產業概論	3	1.基礎
選修	CHE3043	半導體製程技術概論	3	2.進階
選修	CHE4020	半導體封裝概論	3	2.進階
選修	CHE2030	電漿技術於半導體產業之應用	3	3.應用

取得資格總學分： 9

必修學分數： 0

選修學分數： 9

對應產業類別：

C26	電子零組件製造業
-----	----------

學程修課規則：

一、修讀對象/先備知識

修習過普通物理、普通化學課程之學生為宜。

二、取得微學程的修業規定

(一)取得微學程之最低學分數：9學分

學生從基礎、核心、進階/應用課程每個類型至少修習1門科目。

(二)承認微學程之科目學分

1. 科目名稱或內容相同者，承認學分數不得重複計算。

2. 修習之科目實際學分數超過微學程承認學分數，則以承認學分數計算。如實際學分數低於微學程承認學分數，則以實際學分數計算。

(三)學生修滿規定之科目學分者，得依逢甲大學跨領域學程設置要點第7點規定，經本微學程審查修畢學分確認後，由學校發給微學程證明書。

三、對接專長/能力

可接軌半導體材料、綠色塗料及高階生醫產業，更能具備開發特用化學品與創新醫材的職涯競爭力，成為跨領域的化工與材料科技人才。

四、對接產業：

1. 對接產業類別：半導體產業

2. 職業名稱：半導體工程師、製程工程師

五、企業雇主對人才的需求

本微學程聚焦半導體製造核心鏈，學生將掌握從有機光電材料特性、晶圓製程、電漿蝕刻應用到後段封裝測試的完整技術素養。透過產業趨勢分析、製程模擬與技術案例拆解，學生能深度理解半導體產業鏈的運作邏輯與技術實務。

管理單位：工程與科學學院 / 化學工程學系